



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月6日

東

上場会社名 株式会社東京精密 上場取引所 東
 コード番号 7729 URL <https://www.accretech.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長CEO (氏名) 木村 龍一
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員常務COO (氏名) 小泉 公人 TEL 042-642-1701
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績 (2025年4月1日～2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第3四半期	112,971	9.5	20,932	9.7	21,717	9.7	14,148	△21.9
2025年3月期第3四半期	103,137	16.0	19,075	32.6	19,791	31.4	18,125	70.7

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 14,781百万円(△19.5%) 2025年3月期第3四半期 18,361百万円(53.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	348.97	346.70
2025年3月期第3四半期	448.08	444.19

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第3四半期	237,866	180,937	75.3
2025年3月期	237,952	176,229	73.2

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 179,143百万円 2025年3月期 174,221百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2025年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	114.00	—	139.00	253.00
2026年3月期(予想)	—	111.00	—	111.00	222.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通期	165,000	9.6	32,000	7.7	32,000	6.9	21,500	△16.1

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年3月期3Q	42,275,481株	2025年3月期	42,170,081株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	1,695,166株	2025年3月期	1,705,289株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2026年3月期3Q	40,544,560株	2025年3月期3Q	40,451,168株

(注) 当社は、2025年3月期中間期より株式給付信託（BBT）を導入しており、期末自己株式数については、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式（2026年3月期第3四半期189,700株、2025年3月期200,000株）が含まれています。また、期中平均株式数の算定上控除する自己株式数については当該信託が保有する当社株式（2026年3月期第3四半期194,798株）が含まれています。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっては、添付資料「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1.	当四半期決算に関する定性的情報	2
(1)	経営成績に関する説明	2
(2)	財政状態に関する説明	3
(3)	連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2.	四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1)	四半期連結貸借対照表	4
(2)	四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
	四半期連結損益計算書	6
	四半期連結包括利益計算書	7
(3)	四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
	(継続企業の前提に関する注記)	8
	(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
	(セグメント情報等)	8
	(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、総じて底堅い回復基調が続くながれでも、通商摩擦や地政学的な緊張による下振れリスクが依然高い状況が続きました。米国経済は内需を中心に堅調な市況が継続する一方で、中国経済は不動産投資や個人消費の停滞などにより緩慢な状況が続き、欧州や日本経済の回復は弱い水準に留まりました。

このような状況下、当社を取り巻く環境は、特に半導体製造装置部門でHPC(High Performance Computing)関連の装置需要が前期から引き続き底堅さを維持しました。計測機器部門では、既存設備の更新需要などに加え、非自動車分野の需要が下支えとなりました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、受注高 1,172 億 61 百万円（前年同期比 6.2 %増）、売上高は 1,129 億 71 百万円（前年同期比 9.5 %増）、営業利益 209 億 32 百万円（前年同期比 9.7 %増）、経常利益 217 億 17 百万円（前年同期比 9.7 %増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、141 億 48 百万円（前年同期比 21.9 %減）となりました。なお第2四半期に特別損失を計上しております。

当第3四半期連結累計期間のセグメント別概況は以下の通りです。

【半導体製造装置部門】

半導体製造装置部門の受注高は、生成AIを含むHPC需要、特にHBM(High Bandwidth Memory、広帯域メモリ)向け検査装置やAIパッケージング工程向け加工装置の引き合いが底堅く推移したこと等により、前年同期比で増加しました。

売上高は、受注済案件において、概ね顧客要求納期に沿った出荷を進めることができ、前年同期比で増加しました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の当部門業績は、受注高 872 億 89 百万円（前年同期比 7.5 %増）、売上高 867 億 86 百万円（前年同期比 12.2 %増）、営業利益は 176 億 76 百万円（前年同期比 13.4 %増）となりました。

【計測機器部門】

計測機器部門の受注高は、既存設備の更新需要やハイブリッド車生産に関連した追加投資、また航空・宇宙・防衛など成長が見込まれる業界向け需要などの増加により、前年同期比で増加しました。

売上高は、顧客要求納期に沿った出荷のほか、第2四半期に充放電試験システム事業で一定の売上が計上されたこと等により、前年同期比で増加しました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の当部門業績は、受注高 299 億 71 百万円（前年同期比 2.6 %増）、売上高 261 億 85 百万円（前年同期比 1.6 %増）、営業利益 32 億 55 百万円（前年同期比 6.6 %減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

【資産、負債及び純資産の状況】

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 85 百万円減少し、2,378 億 66 百万円となりました。その主な要因は、建物及び構築物の増加 73 億 40 百万円、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権など売上債権の減少 47 億 19 百万円、製品、原材料、仕掛品などの棚卸資産の増加 42 億 4 百万円、現金及び預金の減少 38 億 61 百万円等です。

当第3四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ 47 億 94 百万円減少し、569 億 29 百万円となりました。その主な要因は、未払法人税等の減少 51 億 25 百万円、長期借入金の減少 40 億円、支払手形及び買掛金、電子記録債務の増加など買掛債務の増加 23 億 16 百万円等です。

当第3四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 47 億 8 百万円増加し、1,809 億 37 百万円となりました。自己資本比率は、75.3%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第3四半期連結会計期間ならびに足許の状況を勘案し、2025年11月4日に発表した当連結会計年度(2026年3月期)の通期業績予想を以下の通り修正します。

今回の修正では、第4四半期の出荷・売上ならびに費用の見通しを反映し、半導体製造装置部門・計測機器部門ともに業績予想を修正（上方修正）しております。

(2026年3月期通期)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期純利益	1株あたり 当期純利益
前回発表予想(A) (2025年11月4日 発表)	百万円 164,000	百万円 31,500	百万円 31,500	百万円 20,500	円 505.52
今回修正予想(B)	165,000	32,000	32,000	21,500	530.16
増減額(B-A)	1,000	500	500	1,000	—
増減率	0.6%	1.6%	1.6%	4.9%	—
前年実績 (2025年3月期)	150,534	29,703	29,939	25,637	633.75

(注) 業績見通し等の将来に関する記述は、内外の経済状況、為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流动資産		
現金及び預金	54,541	50,680
受取手形、売掛金及び契約資産	33,122	27,909
電子記録債権	6,687	7,180
商品及び製品	2,856	3,474
仕掛品	40,053	46,190
原材料及び貯蔵品	26,603	24,052
その他	5,523	5,391
貸倒引当金	△46	△55
流动資産合計	169,341	164,823
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	27,600	34,941
その他（純額）	26,375	23,847
有形固定資産合計	53,975	58,788
無形固定資産		
のれん	224	188
その他	3,504	3,050
無形固定資産合計	3,729	3,238
投資その他の資産		
その他	11,018	11,016
貸倒引当金	△112	—
投資その他の資産合計	10,906	11,016
固定資産合計	68,610	73,043
資産合計	237,952	237,866

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,301	9,782
電子記録債務	8,364	9,199
短期借入金	1,300	1,300
1年内返済予定の長期借入金	5,000	5,000
未払法人税等	5,826	701
契約負債	6,789	6,739
賞与引当金	2,655	2,952
役員賞与引当金	19	10
製品不具合対策引当金	—	2,103
その他	8,676	8,302
流動負債合計	46,933	46,091
固定負債		
長期借入金	13,000	9,000
役員退職慰労引当金	54	62
退職給付に係る負債	811	974
資産除去債務	104	105
その他	818	695
固定負債合計	14,789	10,837
負債合計	61,723	56,929
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,573	11,732
資本剰余金	23,161	23,320
利益剰余金	141,546	145,517
自己株式	△8,430	△8,361
株主資本合計	167,850	172,208
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,030	1,373
為替換算調整勘定	4,306	4,735
退職給付に係る調整累計額	1,034	825
その他の包括利益累計額合計	6,371	6,934
新株予約権	950	668
非支配株主持分	1,056	1,125
純資産合計	176,229	180,937
負債純資産合計	237,952	237,866

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	103,137	112,971
売上原価	60,471	66,944
売上総利益	42,666	46,027
販売費及び一般管理費	23,590	25,095
営業利益	19,075	20,932
営業外収益		
受取利息	33	40
受取配当金	251	229
為替差益	131	506
投資事業組合運用益	66	—
補助金収入	59	87
受取補償金	108	19
その他	215	169
営業外収益合計	866	1,052
営業外費用		
支払利息	99	197
固定資産除売却損	1	—
その他	48	69
営業外費用合計	150	267
経常利益	19,791	21,717
特別利益		
新株予約権戻入益	10	3
投資有価証券売却益	179	191
固定資産売却益	4,303	—
特別利益合計	4,493	194
特別損失		
関係会社清算損	40	—
割増退職金	117	—
製品不具合対策費	—	2,103
特別損失合計	157	2,103
税金等調整前四半期純利益	24,127	19,808
法人税、住民税及び事業税	6,122	5,148
法人税等調整額	△187	438
法人税等合計	5,935	5,586
四半期純利益	18,192	14,222
非支配株主に帰属する四半期純利益	66	73
親会社株主に帰属する四半期純利益	18,125	14,148

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	18,192	14,222
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	30	343
為替換算調整勘定	269	425
退職給付に係る調整額	△129	△209
その他の包括利益合計	169	559
四半期包括利益	18,361	14,781
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	18,260	14,711
非支配株主に係る四半期包括利益	101	69

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	77,362	25,774	103,137
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	77,362	25,774	103,137
セグメント利益	15,589	3,486	19,075

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	86,786	26,185	112,971
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	86,786	26,185	112,971
セグメント利益	17,676	3,255	20,932

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	3,765百万円	4,073百万円
のれんの償却額	36百万円	35百万円